

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the structure of a fluid injection recording head, and relates to the ink JIEETO head which especially formed the delivery in 2 train array aiming at a high density mark copy.

[0002]

[Description of the Prior Art] The non impact recording method is attracting the newest interest to extent which generating of the noise at the time of record can disregard in the very small point to say. In it, high-speed record is possible, and various methods are proposed until now, there are some some by which amelioration was added and commercialized, and the so-called ink jet head recording method for the ability to perform record, without moreover needing fixation processing special to the so-called regular paper is the very leading recording method, and has current and some things by which the efforts to utilization are continued in addition.

[0003] Such an ink jet head recording method makes the globule (dropiet) of the record medium called the so-called ink fly, records by making it adhere to a record member, and is proposed by these people in JP,56-9429,B. What was indicated in this official report heats the ink of the liquid interior of a room, generates air bubbles, makes ink produce a pressure buildup, makes ink jump out of a detailed capillary tube nozzle, and is recorded.

[0004] After that, further, these people advanced research and have proposed the ink jet head of a multi-nozzle type which was indicated to JP,6-98761,B. Since this head is an ink jet head with a dramatically easy configuration with which it came to carry out the laminating of a heating element substrate and the lid substrate (passage substrate), and the delivery was arranged by the single tier, the ink jet head using this invention is beginning to spread through a world widely.

[0005] However, a commercial scene is beginning to require the ink jet head in which the further high density mark copy record is possible. The two-piece laminating of the ink jet head of a multi-nozzle type which was indicated in JP,6-98761,B in order to meet such a demand is carried out, the delivery train is made into two trains, a mutual delivery train is shifted slightly, and there is a method of ****(ing) on a recorded body (paper) side, as it becomes a twice as many **** consistency as this substantially. However, the head unit itself becomes large and this approach is hard to be called not much good approach in order to carry out the two-piece laminating of the independent ink jet head.

[0006]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] This invention is made in view of the fault of the above-mentioned conventional technique, and the object is in offering the new configuration of the ink jet head which makes a high density mark copy possible the 1st. Moreover, it is in enabling fertilization of the ink jet head of such a configuration the 2nd. Moreover, it is in enabling highly precise manufacture of the ink jet head of such a configuration the 3rd. Moreover, it is in enabling it high degree of accuracy and to manufacture cheaply about the ink jet head of such a configuration the 4th. Furthermore, it is in offering the optimization conditions for stabilizing and manufacturing the ink jet head of such a

configuration to the 5th. Moreover, it is in realizing the high-definition mark copy by the ink jet head of such a configuration to the 6th. Furthermore, it is in providing the 7th with the configuration of the ink feed zone by the ink jet head of such a configuration. Moreover, it is in the thing which are depended on the ink jet head of such a configuration the 8th and for which a high-definition mark copy is realized more.

[0007]

[Means for Solving the Problem] Invention of claim 1 has a heat energy generating means for making heat energy act on the record liquid in passage. According to an operation of this heat energy In the fluid injection recording head which said record liquid is made to fly as a drop from a delivery by the applied force accompanying the increment in the volume of these air bubbles, and records by producing and cheating out of air bubbles in the heat energy operation section in said record liquid, and making a recording surface-ed dressing This fluid injection recording head is a fluid injection recording head which carries out a laminating and becomes so that said heat energy operation section and said passage slot may face the passage substrate in which the passage slot was formed to front flesh-side both sides of a substrate, and the heating element substrate which forms said heat energy operation section in said table flesh-side double-sided side of this passage substrate.

[0008] Invention of claim 2 is a fluid injection recording head which forms said passage slot by etching in a fluid injection recording head according to claim 1.

[0009] Invention of claim 3 is a fluid injection recording head which forms said passage slot by anisotropic etching in a fluid injection recording head according to claim 1 or 2.

[0010] Invention of claim 4 is a fluid injection recording head which forms said passage slot by anisotropy ETCHINKU on Si substrate cut down by field (100) crystal orientation in a fluid injection recording head according to claim 1 to 3.

[0011] Invention of claim 5 is a fluid injection recording head whose distance of the pars basilaris ossis occipitalis of passage **** of the front face in which said passage substrate is formed, and the pars basilaris ossis occipitalis of passage **** on the back is 8 or more times of the flute width formed in a fluid injection recording head according to claim 1 to 4.

[0012] Invention of claim 6 is a fluid injection recording head whose thickness of said passage substrate is in 1/2 of said passage channel depth about the variation in the thickness in a fluid injection recording head according to claim 1 to 5.

[0013] invention of claim 7 -- a fluid injection recording head according to claim 1 to 6 -- being, said heating element substrate is a fluid injection recording head which has opening for leading a record liquid to said passage slot.

[0014] Invention of claim 8 is a fluid injection recording head which has the orifice-plate member which formed the delivery in 2 train array at a part for the record liquid discharge part of said passage slot corresponding to said passage slot in a fluid injection recording head according to claim 1 to 7.

[0015]

[Embodiment of the Invention] (Invention of claims 1 and 2) It explains in order of hereafter. First, an accompanying drawing is explained to reference about the configuration and principle of an ink jet head to which this invention is applied. Drawing 1 is known conventionally in drawing for explaining an example of the bubble jet mold recording head to which this invention is applied. The perspective view of the lid substrate with which drawing 1 (A) constitutes a head perspective view, and drawing 1 (B) constitutes a head, and drawing 1 (C) the perspective view of the heating element substrate 2 and drawing 1 (D) It is the perspective view which looked at the lid substrate from the background, and, for one, as for an individual (independent) electrode and 8, a field for an orifice (delivery) and 5 to form passage and for record liquid input and 4 form [a lid substrate and 2] a liquid room in a heating element substrate and 3, as for 6 and 7 are [a common electrode and 9] heating elements among drawing.

[0016] Drawing 2 is drawing for explaining the principle of the expulsion of an ink droplet of the so-called ink jet head of the Bubble Jet using the heat with which this invention is applied suitably.

Drawing 2 (A) is a steady state and the surface tension and external force of ink 10 are in equilibrium in respect of an orifice. A heater 9 is heated, drawing 2 (B) is heated until the skin temperature of a heater

9 rises abruptly and bubbling occurs in a contiguity ink layer, and it is in the condition of being dotted with the minute air bubbles 11.

[0017] Drawing 2 (C) is in the condition the contiguity ink layer rapidly heated all over the heater 9 evaporated in an instant, made the ebullition film, and these air bubbles 11 grew up to be. At this time, only the part air bubbles grew up to be goes up, balance with the external force in an orifice side collapses, and, as for the pressure in a nozzle, the ink column 10 begins to grow from an orifice.

[0018] Drawing 2 (D) is in the condition in which air bubbles 11 grew up to be max, and the ink 10 of the part which is equivalent to the volume of air bubbles from an orifice side is extruded. At this time, it is in the condition that the current is not flowing at a heater 9, and the skin temperature of a heater 9 is descending. The maximum of the volume of air bubbles 11 is a little late for the timing of electric pulse impression.

[0019] Drawing 2 (E) shows the condition that it is cooled in ink etc. and air bubbles 11 began to start contraction. In the point of the ink column 10, it moved forward maintaining the extruded rate, and in the back end section, ink flowed backwards into the nozzle from the orifice side by reduction of nozzle internal pressure with contraction of air bubbles, and the vena contracta has arisen on the ink column. Air bubbles 11 contract further and drawing 2 (F) is in the condition that ink is cooled still more rapidly [a heater side] in contact with a heater side. Since external pressure will be in a condition higher than nozzle internal pressure in respect of an orifice, the meniscus has entered in a nozzle greatly. The point of the ink column 10 becomes a drop 12, and is flying at the rate of 5 - 10 m/sec in the direction of the recording paper. In drawing 2 (G), air bubbles have disappeared thoroughly in the process in which the ink of an orifice is again supplied by capillarity (refill) and returns to the condition of drawing 1 (A).

[0020] In such a configuration and the ink jet head of a principle, this invention makes a delivery train two trains, and proposes the ink jet head from which high ***** (twice as many **** consistency as this) was obtained on the recorded body (for example, paper) side.

[0021] Drawing 3 is drawing showing an example of the fluid injection recording head of this invention, and a laminating is carried out and it constitutes the passage (lid) substrate 1 in which the passage slot was formed to front flesh-side both sides of a substrate, and the heating element substrate 2 in which the heat energy operation section was formed to each field of a passage substrate from this invention so that the heat energy operation section and a passage slot may face.

[0022] The passage substrate 1 in which such a passage slot was formed can obtain easily ink-proof corrosive high metal plates, such as a glass substrate and stainless steel, etc. by double-sided etching. Although it is also possible to form by the mechanical processing approach by a dicing saw etc. as other means, even if a chip arises at the time of processing, (the case of a glass substrate) and weld flash come out (in the case of a metal plate), or it carries out and it sees from about [that high degree of accuracy is not processible] and a cost side, it is not mass production-like and is not a best policy.

[0023] In this invention, a passage slot is formed by etching excellent in process tolerance. Moreover, further, since it can also carry out also to double-sided coincidence, mass production nature is good and, as for head fabrication cost, much etching has dramatically simultaneous and the advantage that it can do very at a low price. Usually, since etching advances isotropic in all the directions, the passage slot cross-section configuration acquired becomes semicircle-like, but when it sees as an ink jet head, nonconformity does not arise especially. In addition, in order to form a highly precise passage slot, it is good to use the photosensitive glass currently sold at the trade name of photograph SERAMU by U.S. Corning, Inc. In this case, since etching advances to a lengthwise direction (the depth direction) mostly, the passage slot of a rectangular cross-section configuration is obtained.

[0024] Next, the heating element substrate 2 used by this invention is explained using drawing 4. In this example, in order to make it drawing not become complicated, only the part of one side is shown among the passage slot of front flesh-side both sides of a substrate, and the heating element substrate. The transverse-plane detail part drawing which looked at drawing 4 (A) from the delivery side of an ink jet head, and drawing 4 (B) are the cutting part drawings which met the B-B line of drawing 4 (A). The recording head 100 shown in drawing 4 has the configuration which is predetermined linear density and by which the liquid discharge part 15 including the delivery 14 (141,142,143) for making a liquid fly

when predetermined width of face and the slot on the depth join the predetermined number ***** passage substrate 1 so that a substrate 2 may be covered was formed on the substrate 2 with which the electric thermal-conversion object 101 is formed in the front face. The heat energy generated from a delivery 14 and the electric thermal-conversion object 101 acts on a liquid, and the liquid discharge part 15 generates air bubbles, and has the heat operation section 16 which is just going to cause the rapid change of state by expansion and contraction of the volume.

[0025] The heat operation section 16 is located in the upper part of the heat release section 17 of the electric thermal-conversion object 101, and is using the heat operating surface 18 as a field in contact with the liquid of the heat release section 17 as the base. The heat release section 17 consists of a lower layer 19 prepared on the substrate 2, an exoergic resistive layer 20 prepared on this lower layer 19, and an up layer 21 prepared on this exoergic resistive layer 20. The electrodes 22 and 23 for energizing in this layer 20 for generating heat are formed in the front face, and the heat release section 17 is formed in the exoergic resistive layer 20 (201,202,203) of these inter-electrode exoergic resistive layers 20. An electrode 22 is an electrode common to the heat release section of each liquid discharge part, and an electrode 23 is a selection electrode for choosing the heat release section of each liquid discharge part, and making it generate heat, and is prepared along with the liquid flow channel of a liquid discharge part.

[0026] In order that the up layer 21 may protect from the liquid which uses the exoergic resistive layer 20 chemically and physically in the heat release section 17, it prevents that between an electrode 22 and 23 short-circuits the exoergic resistive layer 20 and the liquid which is filling the liquid flow channel of the liquid discharge part 15 through a liquid while being isolated, and has further the duty which prevents the electric leak in inter-electrode [adjoining]. Although it has the above functions, the exoergic resistive layer 20 is acidity or alkalinity-proof, and when there is no need that between an electrode 22 and 23 connects too hastily electrically through a liquid, it is not necessary to necessarily form the up layer 21, and it may be designed as an electric thermal-conversion object of a configuration of that a liquid contacts the front face of the exoergic resistive layer 20 promptly.

[0027] The lower layer 19 has a heating-value control function. This lower layer 19 namely, in the case of the drop regurgitation The rate conducted to the heat operation section 18 side rather than the heat generated in the exoergic resistive layer 20 conducts to a substrate 2 side increases as much as possible. After the drop regurgitation (i.e., after the energization to the exoergic resistive layer 20 is turned off), the heat in the heat operating surface 18 and the heat release section 17 is promptly emitted to a substrate 2 side, and it is prepared so that it may quench the liquid in the heat operation section 16, and the generated air bubbles.

[0028] In a thing useful as an ingredient which constitutes the exoergic resistive layer 20, it is a tantalum. - The boride of metals, such as the mixture of SiO₂, tantalum nitride, Nichrome, a silver-palladium alloy, a silicon semi-conductor or a hafnium, a lanthanum, a zirconium, titanium, a tantalum, a tungsten, molybdenum, niobium, chromium, and vanadium, is raised. Metal boride can be mentioned as what was especially excellent in these ingredients that constitute the resistive layer 20 from heat, it is a boronizing hafnium that the property is most excellent also in it, and, subsequently it serves as order of zirconium boride, a boronizing lanthanum, a boronizing tantalum, boronizing vanadium, and boronizing niobium.

[0029] The exoergic resistive layer 20 can be formed using technique, such as electron beam evaporation and sputtering, using the above-mentioned ingredient. Although the thickness of the exoergic resistive layer 20 is the configuration of the area, construction material, and a heat operation part and magnitude, and a thing further determined according to the power consumption in a practical aspect etc. so that the calorific value per unit time amount may become as a request, in the usual case, it is suitably set to 0.01 micrometers - 1 micrometer 0.001 micrometers - 5 micrometers. In this invention, 2000A (0.2 micrometers) sputtering of HfB₂ was carried out as an example.

[0030] As an ingredient which constitutes electrodes 22 and 23, many things of the electrode material usually used are used effectively, specifically aluminum, Ag, Au, Pt, Cu, etc. are mentioned, these are used, and it is prepared in a predetermined location by predetermined magnitude, the configuration, and

thickness by technique, such as vacuum evaporationo. In this invention, 1.4 micrometers was formed by sputtering.

[0031] Without barring transmitting effectively the heat generated in the exoergic resistive layer 20 into a record liquid, I hear that the property required of a protective layer (up layer) 21 protects the exoergic resistive layer 20 from a record liquid, and there is. Silicon oxide, silicon nitride, magnesium oxide, an aluminum oxide, tantalum oxide, a zirconium dioxide, etc. are mentioned to a thing useful as an ingredient which constitutes a protective layer 21. These can also be formed using technique, such as electron beam evaporation and sputtering. Moreover, it is the ingredient with which ceramic ingredients, such as silicon carbide and an aluminum oxide (alumina), are also used suitably. It is usually desirable to set suitably 0.01 micrometers - 10 micrometers of 0.1 micrometers - 5 micrometers of thickness of a protective layer 21 to 0.1 micrometers - 3 micrometers the optimal. In this invention, SiO₂ [1.2-micrometer] was formed by sputtering. Thus, as shown in drawing 3, the laminating of the formed heating element substrate is carried out to both sides of a passage substrate, and it is completed as an ink jet head.

[0032] (Invention of claims 3 and 4) Next, another example of this invention is explained. Here, how to form the passage slot of a passage substrate by the anisotropic etching of a single crystal Si is explained. In this case, isotropic etching does not advance as mentioned above, but according to the direction of a crystallographic axis, the speeds of advance of etching differ and etching advances early only in the direction of a specific crystallographic axis. For example, if anisotropic etching of the Si wafer cut down to the crystal orientation of a field (110) is carried out (110), etching advances to a field and a perpendicular direction and a cross-section configuration can obtain the passage slot on rectangular. And the etching has the description that the passage slot formed is dramatically made to high degree of accuracy unlike what is etched isotropic as mentioned above.

[0033] There is a method of using Si wafer cut down to the crystal orientation of a field (100) as an example of other anisotropic etching, for example. In this case, it has the description that two sides are made to the high degree of accuracy which makes a field (100) and the include angle of 54.7 degrees. As for the etching reagent at the time of performing such anisotropic etching, alkali water solutions, such as a potassium-hydroxide water solution, a hydrazine water solution, and mixed liquor of ethylenediamine and a pyrocatechol, are used.

[0034] Moreover, since Si is easy to be corroded by ink if it remains as it is, the passage substrate formed of the anisotropic etching of a single crystal Si in this way forms a suitable protective coat in a front face. Specifically, the approach of forming SiO₂ in a front face by thermal oxidation is used after passage substrate formation. SiO₂ may be formed in others by sputtering. In addition, the concrete delivery formation approach is performed as follows. That is, to both sides of a passage substrate, through joint material, such as adhesives, a laminating and after joining, a dicing saw cuts a heating element substrate perpendicularly mostly with passage, and a delivery side is started. An example of the cutting conditions by the suitable dicing saw is shown below.

[0035] - Class of blade : NBC-Z600SL (0.3mm in disco company make, the outer diameter of 52mm, thickness)

- Engine-speed:10000 which is a blade - 30000rpm and a blade feed rate : 0.2 - 2 mm/s and cooling water : Pure water filtered with 0.2-micrometer filter [0036] Otherwise, a delivery side may be started with a grinder. In addition, as for the started delivery side, it is desirable to form the ink-proof corrosive protective layer of SiO₂ and Si₃N₄ grade by sputtering etc.

[0037] Drawing 5 (A) forms passage, anisotropic etching of the Si wafer of a field (110) is carried out, it considers [drawing 5 (B) carries out anisotropic etching of the Si wafer of a field (100) for the 4th page of the delivery of the ink jet head which started the 4th page of a delivery, / it forms passage, shows the delivery side of the ink jet head which started the delivery side, and] as staggered arrangement by the upper and lower sides, and the array consistency has doubled.

[0038] (Invention of claim 5) Next, still more nearly another description of this invention is explained. this invention -- the above (claims 3 and 4) -- like -- the anisotropic etching of a single crystal Si -- the passage slot of a passage substrate -- forming -- an after that and heating element substrate -- a

laminating -- it joins, the 4th page of a delivery is started, and an ink jet head is completed. The brittleness of a single crystal Si poses a problem in that case.

[0039] Since the passage slot by Si anisotropic etching of a single crystal has the brittleness which is the characteristic property which a single crystal has while it is dramatically highly precise, unless it chooses the optimal conditions and a head fabrication is performed, the yield on the manufacture will become very low. The brittleness forms the passage slot in the single crystal Si wafer for it further by this invention, although it is also the common knowledge which took up the single crystal Si simply especially. Saying [forming the passage slot] seems thus, to have prepared the factor which stress concentration produces there. And since it is prepared in both sides, the passage substrate of this invention is very weak, in view of the viewpoint of a mechanical strength.

[0040] This invention is made in view of this point, and it joins and it finds out a laminating and optimum conditions which the passage substrate 1 will not damage by the time it starts the 4th page (orifice) of a delivery and makes an ink jet head complete for the passage substrate 1 and the heating element substrate 2. From the first, since Si wafer is an expensive ingredient, it is not desirable [if it thinks simply and the passage substrate 1 will be manufactured to some extent using Si wafer of the above thickness, the problem of only a mechanical-strength side is solvable, but] on profit to use not much thick Si wafer. This invention optimizes the thickness of Si wafer which is made moreover at a low price, without damaging in consideration of this point in the middle of a head fabrication.

[0041] As shown in drawing 5, when considering as the distance between the flute width of the passage 5 in which a is formed, and the pars basilaris ossis occipitalis of passage **** on a side front which has b formed and the pars basilaris ossis occipitalis of passage **** on a background in this invention, so that those relation to $8a \leq b$ may become It found out that a good ink jet head was completed without having been in the middle of the head fabrication, having damaged the passage substrate 1 or being [the check's having **(ed) close in the delivery 4 section and] missing, when deciding the dimension of a passage substrate.

[0042] An example of an examination result is shown in a table 1. here -- the number of passage slots -- 512 one side (they are 1032 pieces in both sides), and a passage slot array consistency -- each one side -- the number of the head which manufactured 50 heads of the monograph affair of 300dpi and 400dpi at a time, respectively, and was completed, without damaging is shown. In addition, the head manufactured here is a V character quirk-like thing, and the conditions of the dicing saw of delivery section formation are as follows.

[0043] - Class of blade : NBC-Z600SL (0.3mm in disco company make, the outer diameter of 52mm, thickness)

- Engine-speed:25000rpm and the blade feed rate which is a blade : 1.8 mm/s and cooling water : If it is made to fill the above relation from the pure-water table filtered with 0.2-micrometer filter, it turns out that the good yield is obtained.

[0044]

[A table 1]

$a = 60 \mu m$ 流路溝配列密度片面 300 dpi		$a = 40 \mu m$ 流路溝配列密度片面 400 dpi	
b (μm)	良品数/全数	b (μm)	良品数/全数
350	10/50	250	8/50
430	38/50	280	31/50
470	50/50	310	50/50
520	50/50	350	50/50
600	50/50	430	50/50

[0045] (Invention of claim 6) Next, still more nearly another description of this invention is explained.

BEST AVAILABLE COPY

this invention -- the table rear face of the passage substrate 1 -- the passage slot 5 -- forming -- the after that and heating element substrate 2 -- a laminating -- since it joins, the 4th page of a delivery is started and an ink jet head is completed, delivery 4 train turns into two trains. Although the precision does not become a problem highly since the distance between adjoining deliveries of each train forms a passage slot by photolithography - etching, depending on the precision of the thickness of a passage substrate, when the precision of the distance between [of two] delivery trains is low, I hear that it is bad, and there is, and eventually, the dot location precision on the recorded body worsens, and it causes high-definition mark copy inhibition. [of delivery train array precision] Of course, it is better for delivery train array precision to manufacture a high head from the beginning, since it is possible to compensate it by electric control (control of the timing to strike) even if delivery train array precision is bad, but it will become the cost rise of a control circuit if it does so.

[0046] As this invention was made in view of this point and shown in drawing 7, that from which the thickness of one passage substrate differs from an edge to an edge is used (when setting thickness to d). A head is manufactured using what changed variation Δd , **** experiment and its assessment are performed, a quality is judged by organoleptics according the **** sample to ten human beings, and thickness variation Δd of the permissible passage substrate 1 is found out. having used it here -- 512 one side (they are 1032 pieces in both sides), and a passage slot 5 array consistency -- one side -- it is each the head of the shape of a V character quirk of 300dpi and 400dpi.

[0047] From a table 2, when passage substrate thickness d makes the variation less than 1/2 of c of a passage channel depth shows that final **** image quality brings a result from which almost satisfaction is obtained. Therefore, in case a passage substrate is formed, it is the start ingredient. It is necessary to make it metal plates, such as a glass substrate and stainless steel, Si wafer, etc. become less than 1/2 of a passage channel depth in which the thickness variation is formed. In addition, what is necessary is for double-sided simultaneous polish just to perform thickness adjustment and management, in order to carry out an ingredient substrate within the limits of such thickness variation.

[0048]

[A table 2]

流路溝深さ c = 4.5 μm 基板基板厚さ d = 5.50 μm 流路溝配列密度片面 300 dpi		流路溝深さ c = 3.2 μm 基板基板厚さ d = 4.10 μm 流路溝配列密度片面 400 dpi	
△d (μm)	良と判断した人数／全人数	△d (μm)	良と判断した人数／全人数
1.0	10/10	1.0	10/10
1.5	10/10	1.5	10/10
2.0	10/10	2.0	7/10
2.5	6/10	2.5	3/10
3.0	2/10	3.0	0/10
3.5	0/10	3.5	0/10
4.0	0/10	4.0	0/10

[0049] (Invention of claim 7) Next, still more nearly another description of this invention is explained. Here, a means to supply ink to the passage slot 5 on this invention is explained. Although what is necessary is to prepare feed zone material (common liquid room to each passage) in the passage slot edge of a delivery and an opposite hand, and just to supply ink to a passage slot fundamentally using capillarity, as shown in drawing 8, here explains other structures.

[0050] Drawing 9 shows an example of this invention, forms a common liquid room like the liquid room 6 of drawing 1 (D) in the passage slot edge of the delivery 4 and opposite hand of the passage substrate 1 here at the 2nd page of the upper and lower sides, and forms opening in the location which counters common liquid room 6' of two heating element substrates, respectively, and he is trying to supply ink

from there.

[0051] Formation of common liquid room 6' may be simultaneously formed by etching at the time of passage slot formation, or only a common liquid room part may etch it for a long time, and it may make the depth deep. In case the opening formation to the heating element substrate 2 forms the heating element substrate 2, it should just form patterns, such as a heating element and an electrode, using a substrate [finishing / formation of opening / beforehand]. It cannot be overemphasized in that case that patterns, such as an electrode, avoid opening and it is formed.

[0052] In addition, when using a single crystal Si wafer as a heating element substrate in opening formation, if anisotropic etching is used, opening of high degree of accuracy can be obtained. As other opening means forming, being based on laser radiation is also possible. In this case, although the precision of opening is not so good, there is an advantage that processing ends for a short time. In addition, when using laser processing, it is also possible to perform opening formation after heating element substrate 2 formation.

[0053] (Invention of claim 8) Next, still more nearly another description of this invention is explained. By this invention, although the regurgitation side of an ink jet head will be started with the dicing saw etc. as shown in drawing 5, other examples are explained here. It is made to be the opening 4 which resin film 1' joined to the end face which showed the example to drawing 10 and started the configuration of the delivery 4 section with the dicing saw etc. here pierced. You may join through suitable joint material, or this resin film may join that resin ingredient itself by thermocompression bonding.

[0054] Next, although it is the approach of forming a delivery 4 in this resin film, the approach of irradiating excimer laser is used suitably. Drawing 11 explains in detail. As a resin film, as for ***** and its thickness, resin, such as Pori Sall John, a polyether ape phone, polyphenylene oxide, polypropylene, and polyimide, is set to 10 micrometers - about 200 micrometers. Drawing 11 (A) shows the place which joined resin film 1' to the delivery end-face section.

[0055] A delivery 4 irradiates excimer laser and is obtained by removing resin, and according to this approach, very precise processing which met the mask pattern (this example round-head pattern) is possible for it. In addition, although the delivery 4 of a round-head configuration is shown, as a delivery 4 which can be used for this invention, it is not limited to this configuration and a triangle, a square, etc. can choose the configuration of arbitration here.

[0056] In addition, if it is the delivery 4 of such a configuration, the advantage that it is not necessary to form an ink-proof corrosive protective layer in the delivery side started as mentioned above will come out. This is because resin film 1' covers a logging side, so it is not necessary to worry about the ink corrosion of the field. And still more nearly another advantage also comes out. It is explained below.

[0057] As shown in drawing 5, when the end face started with the dicing saw etc. is made into the delivery end-face section, the border line (ridgeline) which forms each delivery will be in the condition of having been connected by the straight line formed in case laminating junction of a heating element substrate and the passage substrate is carried out. such a straight line -- almost -- a level difference -- therefore, although it is absent, by capillarity, the ink adhering to an end face appears in being connected between adjoining deliveries enough, and there is, and in order to perform ink injection by which each delivery was stabilized independently, this still causes inhibition.

[0058] Since it is independently formed, without connecting each delivery 4 mutually as the final delivery 4 shows drawing 10 like this invention on the other hand by what was punched by excimer laser etc. at resin film 1', the ink adhering to an end face (resin film plane) is not connected between adjoining deliveries, and does not cheat out of ink injection of an adjoining delivery in instability. Therefore, the image quality acquired also turns into high definition dramatically.

[0059] In addition, although the example which irradiates excimer laser and forms a delivery 4 explained after joining resin film 1' to the end face started with the dicing saw etc., resin film 1' in which the delivery 4 was formed may be beforehand joined to an end face here. Moreover, the metal orifice plate excellent in ink-proof corrosive, such as nickel instead of a resin film, is joined to an end face, and it cannot be overemphasized that it is good also as a delivery.

[0060]

[Effect of the Invention] Effectiveness corresponding to claim 1: Since the laminating of the passage substrate in which the passage slot was formed to front flesh-side both sides of a substrate, and the heating element substrate in which the heat energy operation section was formed to front flesh-side both sides of this passage substrate was carried out so that the heat energy operation section and a passage slot might face, and the fluid injection recording head was constituted, the twice [usual] as many delivery array as this was acquired, and the high density mark copy became possible.

[0061] Effectiveness corresponding to claim 2: Since the passage slot of a fluid injection recording head was formed by etching, fertilization became possible.

[0062] Effectiveness corresponding to claim 3: Since the passage slot of a fluid injection recording head was formed by anisotropic etching, the highly precise passage slot was obtained and the **** engine performance also became good.

[0063] since the highly precise passage slot was obtained, the **** engine performance also became good, since the passage slot of an effectiveness:fluid injection recording head corresponding to claim 4 was formed by anisotropic etching on Si substrate cut down by the crystal orientation of a field (100), and ingredient acquisition became easy further -- high degree of accuracy -- and a fluid injection recording head can be cheaply manufactured now.

[0064] Effectiveness corresponding to claim 5: Since the dimension of a passage substrate was optimized, while the yield of a fluid injection recording head was good and could stabilize and manufacture, fabrication cost does not start beyond the need but the fluid injection recording head could be manufactured cheaply.

[0065] Effectiveness corresponding to claim 6: Although it depended for the array precision of a delivery on the precision of passage substrate thickness, since variation in passage substrate thickness was made less than into 1/2 of a passage channel depth, a final delivery array precision improved and the high-definition mark copy was realized.

[0066] Effectiveness corresponding to claim 7: Since it was made to have opening for leading a record liquid to a passage slot in a heating element substrate, it did not have to consider as the ink feed zone of a minute configuration, and the fluid injection recording head fabrication became easy.

[0067] Effectiveness corresponding to claim 8: Since the configuration of a delivery part became good since it was made to have the orifice-plate member which formed the delivery in 2 train array at a part for the record liquid discharge part of a passage slot corresponding to the passage slot, and the mutual intervention between adjoining deliveries was also lost, ink dischargeability ability is stabilized and much more high-definition mark copy can be realized.

[Translation done.]

* NOTICES *

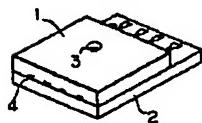
Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

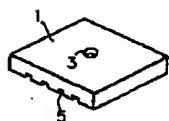
DRAWINGS

[Drawing 1]

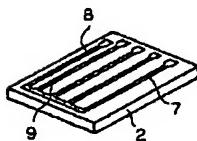
(A)



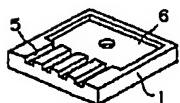
(B)



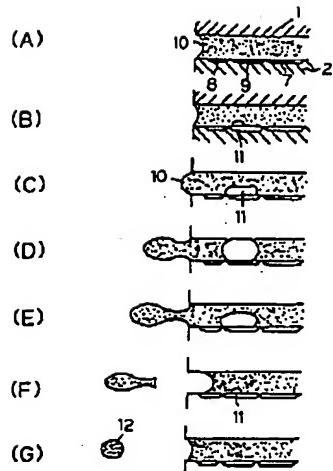
(C)



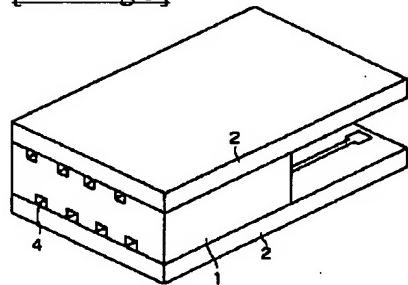
(D)



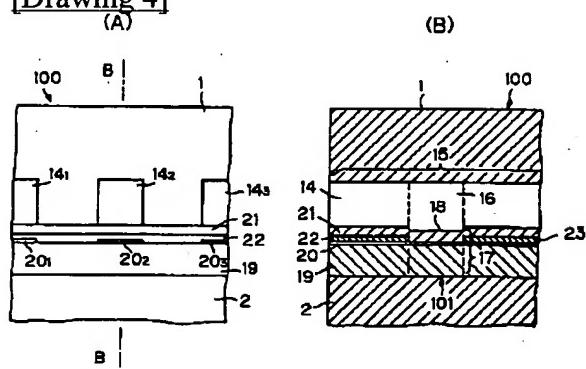
[Drawing 2]



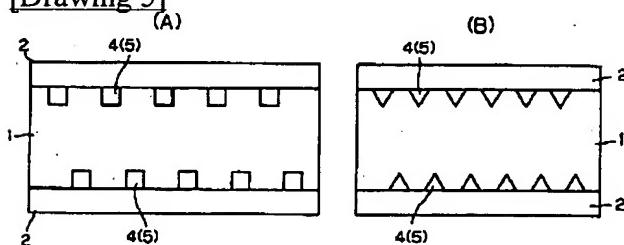
[Drawing 3]



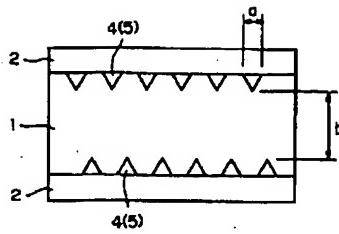
[Drawing 4]



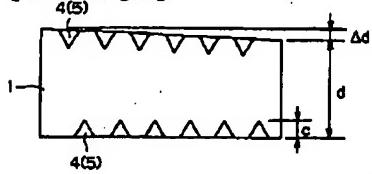
[Drawing 5]



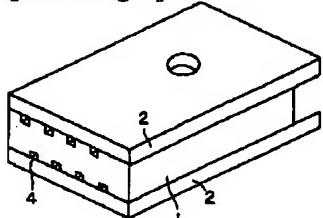
[Drawing 6]



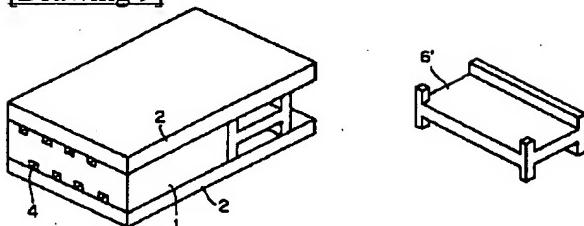
[Drawing 7]



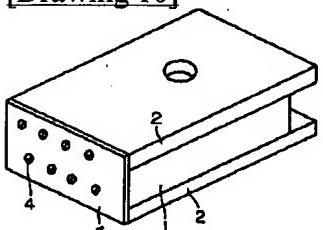
[Drawing 8]



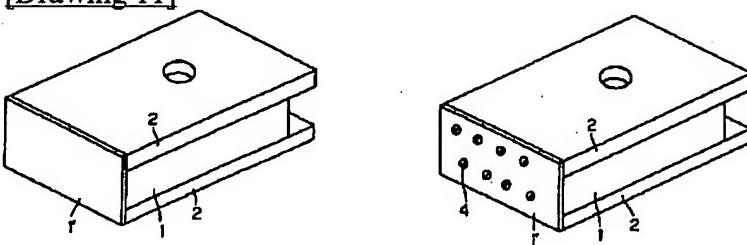
[Drawing 9]



[Drawing 10]



[Drawing 11]



[Translation done.]

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

CORRECTION OR AMENDMENT

[Kind of official gazette] Printing of amendment by the convention of 2 of Article 17 of Patent Law
 [Category partition] The 4th partition of the 2nd category
 [Publication date] August 28, Heisei 14 (2002. 8.28)

[Publication No.] JP,11-170533,A
 [Date of Publication] June 29, Heisei 11 (1999. 6.29)
 [Annual volume number] Open patent official report 11-1706
 [Application number] Japanese Patent Application No. 9-346346
 [The 7th edition of International Patent Classification]

B41J 2/05
 2/16

[FI]

B41J 3/04 103 B
 103 H

[Procedure amendment]
 [Filing Date] June 7, Heisei 14 (2002. 6.7)
 [Procedure amendment 1]
 [Document to be Amended] Description
 [Item(s) to be Amended] Claim
 [Method of Amendment] Modification
 [Proposed Amendment]
 [Claim(s)]

[Claim 1] In the fluid injection recording head which said record liquid is made to fly as a drop from a delivery by the applied force of this energy, and records by having an energy generation means for making energy act on the record liquid in passage, and making a recording surface-ed dressing This fluid injection recording head is a fluid injection recording head which carries out a laminating and becomes so that said energy operation section and said passage slot may face the passage substrate in which the passage slot was formed to front flesh-side both sides of a substrate, and the energy operation substrate which forms said energy operation section in said table flesh-side both sides of this passage substrate.

[Claim 2] Said passage slot is a fluid injection recording head according to claim 1 characterized by forming by etching.

[Claim 3] Said passage slot is a fluid injection recording head according to claim 1 or 2 characterized by forming by anisotropic etching.

[Claim 4] Said passage slot is a fluid injection recording head according to claim 1 to 3 characterized by

forming by anisotropic etching on Si substrate cut down by field (100) crystal orientation.

[Claim 5] Said passage substrate is a fluid injection recording head according to claim 1 to 4 characterized by the distance of the pars basilaris ossis occipitalis of surface passage **** and the pars basilaris ossis occipitalis of passage **** on the back formed being 8 or more times of the flute width formed.

[Claim 6] The thickness of said passage substrate is a fluid injection recording head according to claim 1 to 5 characterized by being in 1/2 of said passage channel depth about the variation in the thickness.

[Claim 7] Said energy operation substrate is a fluid injection recording head according to claim 1 to 6 characterized by having opening for leading a record liquid to said passage slot.

[Claim 8] The fluid injection recording head according to claim 1 to 7 characterized by having the orifice-plate member which formed the delivery in a part for the record liquid discharge part of said passage slot at 2 train array corresponding to said passage slot.

[Procedure amendment 2]

[Document to be Amended] Description

[Item(s) to be Amended] 0007

[Method of Amendment] Modification

[Proposed Amendment]

[0007]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-170533

(43)公開日 平成11年(1999)6月29日

(51)Int.Cl[®]B 41 J
2/05
2/16

識別記号

P I

B 41 J
3/04103 B
103 H

審査請求 本請求 請求項の数8 OL (全10頁)

(21)出願番号

特願平9-346346

(22)出願日

平成9年(1997)12月16日

(71)出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 関谷 順朗

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

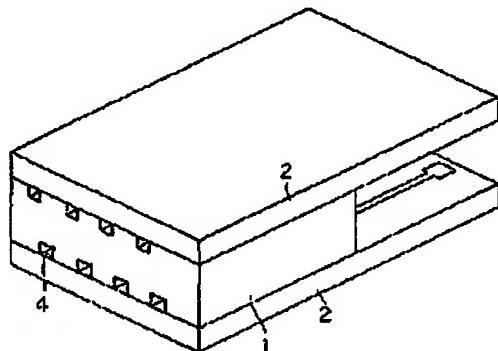
(74)代理人 弁理士 高野 明近

(54)【発明の名称】 液体噴射記録ヘッド

(57)【要約】

【課題】 高密度、高精度かつ高画質のインクジェットヘッドを安価に得ること。

【解決手段】 液体噴射記録ヘッドの流路基板の表裏両面に流路溝を形成すると共に、該流路基板の前記表裏両面に前記熱エネルギー作用部を形成する発熱体基板を前記熱エネルギー作用部と前記流路溝とが対応するよう積層した構成とした。前記発熱体基板は前記流路溝に記録液体を導くための開口を有し、前記流路溝の記録液体吐出部分に、2列配列に吐出口を形成したオリフィスプレート部材を有する構成とすることもできる。また、前記流路基板は、形成される表側の流路溝群の底部と裏の流路群の底部の間の距離が、形成される溝幅の8倍以上、また、前記流路の基板厚さのバラツキを流路溝深さの1/2内とした。前記流路溝は、エッチング又は異方性エッチングによって形成する。



(2)

特開平11-170533

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 流路内の記録液体に熱エネルギーを作用させるための熱エネルギー発生手段を有し、該熱エネルギーの作用により、前記記録液体中の熱エネルギー作用部に気泡を生じせしめ、該気泡の体積増加とともに吐出力で吐出口より前記記録液体を液滴として飛翔させ、該記録面に着付させて記録を行う液体噴射記録ヘッドにおいて、該液体噴射記録ヘッドは、基板の裏表両面に流路溝を形成した流路基板と、該流路基板の前記裏表両面に前記熱エネルギー作用部を形成する発熱体基板を前記熱エネルギー作用部と前記流路溝とが相対するよう構成してなる液体噴射記録ヘッド。

【請求項2】 前記流路溝は、エッティングによって形成することを特徴とする請求項1記載の液体噴射記録ヘッド。

【請求項3】 前記流路溝は、異方性エッティングによって形成することを特徴とする請求項1又は2に記載の液体噴射記録ヘッド。

【請求項4】 前記流路溝は、(100)面極端方位に切り出されたSi基板上に異方性エッティングにより形成することを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の液体噴射記録ヘッド。

【請求項5】 前記流路基板は、形成される表面の流路溝群の底部と裏面の流路溝群の底部の距離が、形成される溝幅の8倍以上であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の液体噴射記録ヘッド。

【請求項6】 前記流路基板の厚さは、その厚さのバラツキを前記流路溝溝の1/2内であることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の液体噴射記録ヘッド。

【請求項7】 前記発熱体基板は、前記流路溝に記録液体を導くための開口を有することを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の液体噴射記録ヘッド。

【請求項8】 前記流路溝の記録液体吐出部分に、前記流路溝に対応して2列配列に吐出口を形成したオリフィスプレート部材を有することを特徴とする請求項1乃至7のいずれかに記載の液体噴射記録ヘッド。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、液体噴射記録ヘッドの構造に関するものであり、とりわけ高密度印写を目的とした、2列配列に吐出口を形成したインクジェットヘッドに関するものである。

【0002】

【従来の技術】 ノンインパクト記録法は、記録時における騒音の発生が無視し得る程度に極めて小さい点において、最新機種を算めている。その中で、高速記録が可能であり、しかもいわゆる普通紙に特別の定着処理を必要とせずに記録の行える、いわゆるインクジェットヘッド記録法は極めて有力な記録法であって、これまでに

2

も、様々な方式が提案され、改良が加えられ商品化されたものもあれば、現在もなお実用化への努力が続けられているものもある。

【0003】 このようなインクジェットヘッド記録法は、いわゆるインクと称される記録媒体の小滴 (drop) を飛翔させ、記録部材に付着させて記録を行うものであって、例えば、本出願人により特公昭56-9429号公報において提案されている。この公報で開示されたものは、液室内のインクを加熱して気泡を発生させて

10 インクに圧力を生じさせ、微細な毛細管ノズルからインクを飛び出させて記録するものである。

【0004】 本出願人は、その後さらに、研究を進め、特公平6-98761号公報に開示したようなマルチノズルタイプのインクジェットヘッドを提案している。このヘッドは、発熱体基板と蓋基板(流路基板)を積層してなり、吐出口が一列に配列された非常に構成の簡単なインクジェットヘッドであるため、この発明を利用したインクジェットヘッドは広く世の中に普及し始めている。

20 【0005】 しかしながら市場は、さらなる高密度印写記録が可能なインクジェットヘッドを要求し始めている。このような要求に応えるために、例えば、特公平6-98761号公報において開示したようなマルチノズルタイプのインクジェットヘッドを2個積層して、その吐出口列を2列とし、互いの吐出口列をわずかにずらし、該記録体(紙)面上で実質的に2倍の印写密度になるようにして印写する方法がある。しかしながら、この方法は、独立したインクジェットヘッドを2個積層するため、ヘッドユニットそのものが大きくなり、あまり良い方法とはいえない。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、上記従来技術の欠点に鑑みられたものであり、その目的は、第1に、高密度印写を可能とするインクジェットヘッドの新規な構成を提供することにある。また、第2に、そのような構成のインクジェットヘッドの量産化を可能することにある。また、第3に、そのような構成のインクジェットヘッドの高精度な製造を可能にすることにある。また、第4に、そのような構成のインクジェットヘッドを高精度かつ安価に製作できることにある。

さらに、第5に、そのような構成のインクジェットヘッドを安定して製作するための最適化条件を提供することにある。また、第6に、そのような構成のインクジェットヘッドによる高画質印写を実現することにある。さらに、第7に、そのような構成のインクジェットヘッドによるインク供給部の構成を提供することにある。また、第8に、そのような構成のインクジェットヘッドによる、より高画質印写を実現することにある。

【0007】

50 【課題を解決するための手段】 請求項1の発明は、流路

(3)

特開平11-170533

3

内の記録液体に熱エネルギーを作用させるための熱エネルギー発生手段を有し、該熱エネルギーの作用により、前記記録液体中の熱エネルギー作用部に気泡を生じせしめ、該気泡の体積増加にともなう作用力で吐出口より前記記録液体を液滴として飛翔させ、該記録面に着付させて記録を行う液体噴射記録ヘッドにおいて、該液体噴射記録ヘッドは、基板の表裏両面に流路溝を形成した流路基板と、該流路基板の前記表裏両面に前記熱エネルギー作用部を形成する発熱体基板を前記熱エネルギー作用部と前記流路溝とが相対するように積層してなる液体噴射記録ヘッドである。

【0008】請求項2の発明は、請求項1記載の液体噴射記録ヘッドにおいて、前記流路溝は、エッティングによって形成する液体噴射記録ヘッドである。

【0009】請求項3の発明は、請求項1又は2に記載の液体噴射記録ヘッドにおいて、前記流路溝は、異方性エッティングによって形成する液体噴射記録ヘッドである。

【0010】請求項4の発明は、請求項1乃至3のいずれかに記載の液体噴射記録ヘッドにおいて、前記流路溝は、(100)面結晶方位に切り出されたS₁基板上に異方性エッティングにより形成する液体噴射記録ヘッドである。

【0011】請求項5の発明は、請求項1乃至4のいずれかに記載の液体噴射記録ヘッドにおいて、前記流路溝は、形成される裏面の流路溝群の底部と裏面の流路溝群の底部の距離が、形成される溝幅の8倍以上である液体噴射記録ヘッドである。

【0012】請求項6の発明は、請求項1乃至5のいずれかに記載の液体噴射記録ヘッドにおいて、前記流路溝基板の厚さは、その厚さのバラツキを前記流路溝深さの1/2内である液体噴射記録ヘッドである。

【0013】請求項7の発明は、請求項1乃至6のいずれかに記載の液体噴射記録ヘッドにおいて、前記発熱体基板は、前記流路溝に記録液体を導くための開口を有する液体噴射記録ヘッドである。

【0014】請求項8の発明は、請求項1乃至7のいずれかに記載の液体噴射記録ヘッドにおいて、前記流路溝の記録液体吐出部分に、前記流路溝に対応して2列配列に吐出口を形成したオリフィスプレート部材を有する液体噴射記録ヘッドである。

【0015】

【発明の実施の形態】(請求項1、2の発明)以下、順に説明する。最初に、本発明が適用されるインクジェットヘッドの構成および原理について、添付図面を参考に説明する。図1(A)は、本発明が適用されるパブルジェット型記録ヘッドの一例を説明するための図で従来より知られているものである。図1(A)はヘッド斜視図、図1(B)はヘッドを構成する蓋基板の斜視図、図1(C)は発熱体基板2の斜視図、図1(D)は、蓋基板を裏側

4

から見た斜視図であり、図中、1は蓋基板、2は発熱体基板、3は記録液体流入口、4はオリフィス(吐出口)、5は流路、6は液室を形成するための領域、7は個別(独立)電極、8は共通電極、9は発熱体である。

【0016】図2は、本発明が好適に適用される熱を利用するいわゆるパブルジェット方式のインクジェットヘッドのインク滴吐出の原理を説明するための図である。

図2(A)は定常状態であり、オリフィス面でインク10の表面張力と外力とが平衡状態にある。図2(B)はヒータ9が加熱されて、ヒータ9の表面温度が急上昇し瞬接インク層に蒸騰現象が起きるまで加熱され、微小気泡11が点在している状態にある。

【0017】図2(C)はヒータ9の全面で急激に加熱された瞬接インク層が瞬時に気化し、蒸騰膜を作り、この気泡11が成長した状態である。この時、ノズル内の圧力は、気泡の成長した分だけ上昇し、オリフィス面での外力とのバランスがくずれ、オリフィスよりインク柱10が成長し始める。

【0018】図2(D)は気泡11が最大に成長した状態であり、オリフィス面より気泡11の体積に相当する分のインク10が押し出される。この時、ヒータ9には鳴流が流れていない状態にあり、ヒータ9の表面温度は低下しつつある。気泡11の体積の最大値は鳴気パルス印加のタイミングからやや遅れる。

【0019】図2(E)は気泡11がインクなどにより冷却されて収縮を開始し始めた状態を示す。インク柱10の先端部では押し出された速度を保ちつつ前進し、後端部では気泡の収縮に伴ってノズル内圧の減少によりオリフィス面からノズル内へインクが逆流してインク柱にくびれが生じている。図2(F)はさらに気泡11が収縮し、ヒータ面にインクが接しヒータ面がさらに急激に冷却される状態にある。オリフィス面では、外圧がノズル内圧より高い状態になるため、メニスカスが大きくノズル内に入り込んできている。インク柱10の先端部は液滴12になり、記録紙の方向へ5~10m/secの速度で飛翔している。図2(G)はオリフィスのインクが毛細管現象により再び供給(リフィル)されて、図1(A)の状態に戻る過程で気泡は完全に消滅している。

【0020】本発明は、このような構成および原理のインクジェットヘッドにおいて、吐出口列を2列にし、被記録体(例えば、紙)面上で、高密印写(2倍の印写密度)が得られるようにしたインクジェットヘッドを提案するものである。

【0021】図3は、本発明の液体噴射記録ヘッドの一例を示す図で、本発明では基板の表裏両面に流路溝を形成した流路(蓋)基板1と、流路基板のそれぞれの面に熱エネルギー作用部を形成した発熱体基板2を、熱エネルギー作用部と流路溝とが相対するよう積層して構成したものである。

【0022】このような流路溝を形成した流路基板1

(4)

特開平11-170533

5

は、例えば、ガラス基板やステンレス等の耐インク腐食性の高い金属板などを両面エッチングにより、容易に得ることができる。他の手段として、ダイシングソーラ等による機械的な加工方法によって形成することも可能ではあるが、加工時に欠けが生じたり（ガラス基板の場合）、バリが出たり（金属板の場合）して、高精度に加工できないばかりか、コスト面から見ても産業的ではなく得策ではない。

【0023】本発明では、加工精度に優れたエッチングによって流路溝を形成する。また、エッチングは、多数個同時、さらに、両面同時にを行うこともできるので、非常に産業性がよく、ヘッド製作コストは非常に安くできるという利点がある。通常エッチングは、あらゆる方向に等方的に進行するので、得られる流路溝断面形状は半円状となるが、インクジェットヘッドとしてみた場合、特に、不具合が生じることははない。なお、より高精度な流路溝を形成するには、例えば、米コーニング社よりフォトセラムの商品名で売られている感光性ガラスを使用するとよい。この場合には、ほぼ横方向（深さ方向）にエッチングが進行するので、矩形の断面形状の流路溝が得られる。

【0024】次に、本発明で使用する発熱体基板2について図4を用いて説明する。この例では、図が複雑にならないようにするために、基板の裏表両面の流路溝および発熱体基板のうち片面の部分のみを示している。図4(A)はインクジェットヘッドの吐出口側から見た正面詳細部分図、図4(B)は図4(A)のB-B線に沿った切断部分図である。図4に示された記録ヘッド100は、その表面に電気熱変換体101が設けられている基板2上に、所定の線密度で、所定の幅と深さの溝が所定数設けられている流路基板1を、基板2を覆うように接合することによって、液体を飛翔させるための吐出口14(141, 142, 143)を含む液吐出部15が形成された構成を有している。液吐出部15は、吐出口14と電気熱変換体101より発生される熱エネルギーが液体に作用して気泡を発生させ、その体積の膨張と収縮による急激な状態変化を引き起こすところである熱作用部16を有する。

【0025】熱作用部16は、電気熱変換体101の熱発生部17の上部に位置し、熱発生部17の液体と接触する面としての熱作用面18をその底面としている。熱発生部17は、基板2上に設けられた下部層19、該下部層19上に設けられた発熱抵抗層20、該発熱抵抗層20上に設けられた上部層21とで構成される。発熱抵抗層20(201, 202, 203)には、熱を発生させるための該層20に通電するための電極22, 23がその表面に設けられており、これらの電極間の発熱抵抗層20によって熱発生部17が形成されている。電極22は、各液吐出部の熱発生部に共通の電極であり、電極23は、各液吐出部の熱発生部を選択して発熱させるため

6

の選択電極であって、液吐出部の液流路に沿って設けられている。

【0026】上部層21は、熱発生部17においては、発熱抵抗層20を使用する液体から化学的、物理的に保護するために、発熱抵抗層20と液吐出部15の液流路を溝たしている液体とを隔離するとともに、液体を通じて電極22, 23間に短絡するのを防止し、さらに、隣接する電極間ににおける電気的リードを防止する役目を有している。上部層21は、上記のような機能を有するものであるが、発熱抵抗層20が耐液性であり、かつ液体を通じて電極22, 23間に電気的に短絡する必要が全くない場合には、必ずしも設ける必要はなく、発熱抵抗層20の表面に直ちに液体が接触する構成の電気熱変換体として設計してもよい。

【0027】下部層19は、熱制御機能を有する。すなわち、この下部層19は液滴吐出の際には、発熱抵抗層20で発生する熱が基板2側に伝導するよりも、熱作用部18側に伝導する割合ができる限り多くなり、液滴吐出後、つまり、発熱抵抗層20への通電がOFFされ20た後には、熱作用面18および熱発生部17にある熱が速やかに基板2側に放出されて、熱作用部16にある液体および発生した気泡が急冷されるように設けられたものである。

【0028】発熱抵抗層20を構成する材料として有用なものには、タンタル-SiO₂の混合物、窒化タンタル、ニクロム、銀-パラジウム合金、シリコン半導体、あるいはハフニウム、ランタン、ジルコニア、チタン、タンタル、タンクステン、モリブデン、ニオブ、クロム、バナジウム等の金属の硼化物があげられる。熱発30抵抗層20を構成するこれらの材料の中、殊に優れたものとして金属硼化物を挙げることができ、その中でも最も特性の優れているのが硼化ハフニウムであり、次いで、硼化ジルコニア、硼化ランタン、硼化タンタル、硼化バナジウム、硼化ニオブの順となっている。

【0029】発熱抵抗層20は、上記の材料を用いて、電子ビーム蒸着やスパッタリング等の手法を用いて形成することができる。発熱抵抗層20の膜厚は、単位時間当たりの発熱量が所定通りとなるように、その面積、材質および熱作用部分の形状および大きさ、さらには実際面での消費電力等に従って決定されるものであるが、通常の場合、0.001 μm～5 μm、好適には、0.01 μm～1 μmとされる。本発明では、一例として、HfB₂を、2000 Å(0.2 μm)スパッタリングした。

【0030】電極22, 23を構成する材料としては、通常使用されている電極材料の多くのものが有効に使用され、具体的には、例えば、Al, Ag, Au, Pt, Cu等が挙げられ、これらを使用して、蒸着等の手法で所定位に所定の大きさ、形状、厚さで設けられる。本発明では、スパッタリングにより、1.4 μm形成した。

(5)

特開平11-170533

7

【0031】保護層（上部層）21に要求される特性は、発熱抵抗層20で発生された熱を記録液体に効果的に伝達することを妨げずに、記録液体より発熱抵抗層20を保護するということである。保護層21を構成する材料として有用なものには、例えば、酸化シリコン、塗化シリコン、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化ジルコニウム等が挙げられる。これらは、電子ビーム蒸着やスパッタリング等の手法を用いて形成することもできる。また、炭化ケイ素、酸化アルミニウム（アルミナ）等のセラミック材料も好適に用いられる材料である。保護層21の膜厚は、通常は、0.01 μm～10 μm、好適には、0.1 μm～5 μm、最適には、0.1 μm～3 μmとされるのが望ましい。本発明では、スパッタリングにより、SiO₂を1.2 μm形成した。このように形成した発熱体基板は、図3に示したように、流路基板の両面に積層してインクジェットヘッドとして完成する。

【0032】（請求項3、4の発明）次に、本発明の別の実施例を説明する。ここでは流路基板の流路溝を単結晶Siの異方性エッチングによって形成する方法を説明する。この場合は、上記のように等方性エッチングが進行するのではなく、結晶軸の方向によってエッチングの進行速度が異なり、特定の結晶軸の方向にのみエッチングが早く進行する。例えば、(110)面の結晶方位に切り出したSiウェハを異方性エッチングすると(110)面と垂直方向にエッチングが進行し、断面形状が矩形の流路溝を得ることができる。そして、そのエッチングは上記のように等方的にエッチングされるものとは異なり、形成される流路溝が非常に高精度にできるという特徴を有する。

【0033】他の異方性エッチングの例としては、例えば、(100)面の結晶方位に切り出したSiウェハを利用する方法がある。この場合は、2度を(100)面と54.7°の角度をなす高精度にできるという特徴を有する。これらの異方性エッチングを行う際のエッチング液は、水酸化カリウム水溶液、ヒドラジン水溶液、エチレンジアミンとピロカテコールの混合液等のアルカリ水溶液が用いられる。

【0034】また、このように単結晶Siの異方性エッチングによって形成された流路基板は、そのままではSiがインクによって腐食されやすいので、適切な保護膜を表面に形成する。具体的には、流路基板形成後に熱酸化によって表面にSiO₂を形成する方法が用いられる。他にはスパッタリングによってSiO₂を形成してもよい。なお、具体的な吐出口形成方法は、以下のように行われる。すなわち、流路基板の両面に発熱体基板を接着剤等の接合部材を介して積層、接合した後、流路とほぼ垂直方向にダイシングソーによって切断し、吐出口面を切り出す。好適なダイシングソーによる切断条件の一例を以下に示す。

8

【0035】・ブレードの種類：NBC-2600S
L（ディスコ社製、外径52mm、厚さ0.3mm）
・ブレードの回転数：10000～30000 rpm
・ブレード送り速度：0.2～2 mm/s
・冷却水：0.2 μmフィルターで濾過した純水

【0036】他にグラインダーによって吐出口面を切り出しててもよい。なお、切り出された吐出口面は、スパッタリング等によってSiO₂、Si_xN_y等の耐インク腐食性保護層を形成することが望ましい。

【0037】図5(A)は、(110)面のSiウェハを異方性エッチングして流路を形成し、吐出口4面を切り出したインクジェットヘッドの吐出口4面を、図5(B)は(100)面のSiウェハを異方性エッチングして流路を形成し、吐出口面を切り出したインクジェットヘッドの吐出口面を示しており、上下で千鳥配列とし配列密度は2倍になっている。

【0038】（請求項5の発明）次に、本発明のさらに別の特徴について説明する。本発明では、上記（請求項3、4）のように、単結晶Siの異方性エッチングによって流路基板の流路溝を形成し、その後、発熱体基板に積層、接合し、吐出口4面を切り出してインクジェットヘッドを完成させる。その際、問題となるのは、単結晶Siの脆さである。

【0039】単結晶のSi異方性エッチングによる流路溝は非常に高精度である反面、単結晶の持つ特有の性質である脆さがあるため、最適な条件を選んでヘッド製作を行わない限り、その製造上の歩留まりは、非常に低いものとなる。特に、単純に単結晶Siを取り上げただけでもその脆さは周知であるが、本発明では、さらにその単結晶Siウェハに流路溝を形成している。このように流路溝を形成しているということは、そこに応力集中が生じる因子を設けているようなものである。しかもそれを両面に設けているため、本発明の流路基板は、機械的強度という観点からみると、非常に弱いものである。

【0040】本発明は、この点に鑑みてなされたものであり、流路基板1と発熱体基板2を積層、接合し、吐出口（オリフィス）4面を切り出してインクジェットヘッドを完了させるまでの間に、流路基板1が破損しないような、最適条件を見い出したものである。单純に考えればある程度以上の厚さのSiウェハを用いて、流路基板1を製作すれば、機械的強度面のみの問題は解決できるが、もともとSiウェハは高価な材料であるため、あまり厚いSiウェハを用いることは、採算上好ましくない。本発明はこの点を考慮し、ヘッド製作途中に破損することなく、しかも、最も安くできるようなSiウェハの厚さを最適化したものである。

【0041】本発明では、図5に示すように、aを形成される流路5の溝幅、bを形成される表側の流路溝群の底部と裏側の流路溝群の底部間の距離とする時、それら

(5)

特開平11-170533

9

10

の関係が $8 \text{ a} \leq b$ となるように、流路基板の寸法を決めれば、ヘッド製作途中で流路基板 1 が破損したり、吐出口 4 部にひびが入り、欠けたりしないで、良好なインクジェットヘッドが完成することを見出したことである。

【0042】表 1 に検討結果の一例を示す。ここでは、流路溝数が、片面 512 個（両面で 1032 個）、流路溝配列密度が片面それぞれ 300 dpi, 400 dpi の各条件のヘッドをそれぞれ 50 個ずつ製作し、破損することなく完成したヘッドの個数を示している。なお、ここで製作したヘッドは、V 字溝形状のものであり、吐出口部形成のダイシングゾーの条件は以下の通りであ *

* る。

【0043】・ブレードの種類：NBC-2600S
L（ディスコ社製、外径 5.2 mm、厚さ 0.3 mm）
・ブレードの回転数：25000 rpm
・ブレード送り速度：1.8 mm/s
・冷却水：0.2 mm フィルターで通過した純水
より上記のような関係を満たすようにすれば、良好な歩留まりが得られることがわかる。

10 【0044】

【表 1】

$a = 60 \mu\text{m}$ 流路溝配列密度片面 300 dpi		$a = 40 \mu\text{m}$ 流路溝配列密度片面 400 dpi	
b (μm)	良品数/全数	b (μm)	良品数/全数
350	10/50	250	8/50
400	38/50	260	31/50
470	50/50	310	50/50
520	50/50	350	50/50
600	50/50	430	50/50

【0045】（請求項 6 の発明）次に、本発明のさらに別の特徴について説明する。本発明では、流路基板 1 の表裏面に流路溝を形成し、その後、発熱体基板 2 に積層、接着し、吐出口 4 面を切り出してインクジェットヘッドを完成させるので、吐出口 4 列は 2 列になる。各列の隣接吐出口間距離は、流路溝をフォトリソグラフィー～エッチングによって形成するので、その精度は高く問題にならないが、2 つの吐出口列間距離は、流路基板の厚さの精度に依存し、その精度が低いと吐出口列配列精度が悪いということであり、最終的には被記録体上でのドット位置精度が悪くなり、高画質印写阻害要因となる。もちろん、吐出口列配列精度が悪くても、電気的制御（打つタイミングの制御）によって、それを補償することは可能であるが、そうすると制御回路のコストアップとなるので、最初から吐出口列配列精度が高いヘッドを製作する方がよい。

【0046】本発明は、この点に鑑みてなされたもので、図 7 に示すように、1 枚の流路基板の厚さが端から端まで異なるものを用いて（厚さを d とするとき、バラ

ツキ d を変えたものを用いて）ヘッドを製作し、印写実験およびその評価を行い、その印写サンプルを 10 人の人間による官能試験によって良否を判断し、許容できる流路基板 1 の厚さバラツキ d を見い出したものである。ここで使用したのは、片面 512 個（両面で 1032 個）、流路溝 5 配列密度が片面それぞれ 300 dpi, 400 dpi の V 字溝形状のヘッドである。

【0047】表 2 より、流路基板厚さ d は、そのバラツキを流路溝深さの c の $1/2$ 以内とすることによって、最終的な印写画質がほぼ満足の得られる結果となることがわかる。よって流路基板を形成する際に、その出発材料である。ガラス基板、ステンレス等の金属板、SUS 等は、その厚さバラツキが形成される流路溝深さの $1/2$ 以内となるようにする必要がある。なお、材料基板をこのような厚さバラツキの範囲内にするためには、両面同時研磨によって厚さ調整、管理を行えばよい。

40 【0048】

【表 2】

(7)

特開平11-170533

11

流路基板さ c = 4.5 μm 基板基板厚さ d = 5.50 μm 試験条件列底段片面 300 dpi		流路基板さ c = 3.2 μm 基板基板厚さ d = 4.10 μm 流路基板条件底段片面 400 dpi	
△d (μm)	良と判断した人數／全人數	△d (μm)	良と判断した人數／全人數
1.0	10/10	1.0	10/10
1.5	10/10	1.5	10/10
2.0	10/10	2.0	7/10
2.5	9/10	2.5	3/10
3.0	2/10	3.0	0/10
3.5	0/10	3.5	0/10
4.0	0/10	4.0	0/10

12

【0049】(請求項7の発明) 次に、本発明のさらには別の特徴について説明する。ここでは、本発明の流路溝5にインクを供給する手段について説明する。基本的には、図8に示すように、吐出口と反対側の流路溝端部に、供給部材(各流路に対する共通液室)を設け、毛管現象を利用して流路溝にインクを供給すればよいが、ここでは他の構造について説明する。

【0050】図9は、本発明の一例を示しており、ここでは流路基板1の吐出口4と反対側の流路溝端部に図1(D)の液室6のような共通液室を上下2面に形成し、2枚の発熱体基板の共通液室6'に対向する位置にそれぞれ開口を形成し、そこからインクを供給するようにしている。

【0051】共通液室6'の形成は、流路溝形成時に同時にエッティングによって形成するか、あるいは共通液室部分のみエッティングを長く行い、深さを深くしてもよい。発熱体基板2への開口形成は、例えば、発熱体基板2を形成する際にあらかじめ開口を形成済みの基板を用い、発熱体や電極等のパターンを形成すればよい。その際、電極等のパターンは開口部をさけて形成されることはないまでもない。

【0052】なお、開口形成にあたっては、発熱体基板として、単結晶Siウェハを使用する場合には、異方性エッティングを利用すると高精度の開口を得ることができる。他の開口形成手段としては、レーザー照射によることも可能である。この場合、開口の精度はそれほどよくないが、加工が短時間ですむという利点がある。なお、レーザー加工を利用する場合は、発熱体基板2形成後に開口形成を行うことも可能である。

【0053】(請求項8の発明) 次に、本発明のさらには別の特徴について説明する。本発明では、図5に示すように、インクジェットヘッドの吐出面は、ダイシングソー等で切り出した状態になっているが、ここでは他の例を説明する。図10にその例を示し、ここでは吐出口4部の構成をダイシングソー等で切り出した端面に接合された樹脂フィルム1'にせん孔された開口4であるよう

にしている。この樹脂フィルムは、適当な接合部材を介して接合しても良いし、あるいはその樹脂材料そのものを熱圧着によって接合しても良い。

【0054】次に、この樹脂フィルムに吐出口4を形成する方法であるが、エキシマレーザを照射する方法が好適に用いられる。図11により詳しく説明する。樹脂フィルムとして、例えば、ポリザルファン、ポリエーテルザルファン、ポリフェニレンオキサイド、ポリプロピレン、ポリイミドなどの樹脂が用られ、その厚さは、例えば、1.0 μm～2.0 μm程度とされる。図11(A)は吐出口端面部に樹脂フィルム1'を接合したところを示している。

【0055】吐出口4は、エキシマレーザを照射して、樹脂を除去することによって得られ、この方法によると、マスクパターン(この例では、九パターン)に沿った非常に精密な加工が可能である。なお、ここでは、丸形状の吐出口4を示しているが、本発明に使用できる吐出口4としては、この形状に限定されるものではなく、三角形、正方形等、任意の形状を選ぶことができる。

【0056】なお、このような構成の吐出口4とする。前述のように切り出された吐出口面に、耐インク腐食性保護層を形成しなくてもよいという利点が出てくる。これは樹脂フィルム1'が、切り出し面をカバーするため、その面のインク腐食を心配する必要がないからである。そして、さらに別の利点も出てくる。以下にそれを説明する。

【0057】図6に示したようにダイシングソー等で切り出した端面を吐出口端面部とした場合、各吐出口を形成する輪郭線(縁線)が、発熱体基板と流路基板を横面接合する際に形成される直線によってつながった状態となる。このような直線は、ほとんど段差がついてはいないが、それでも毛管現象によって、端面に付着したインクが、隣接吐出口間につながるには十分であり、個々の吐出口が独立して安定したインク噴射を行うためには、これは阻害要因となる。

【0058】一方、本発明のように、最終的な吐出口4

(8)

特開平11-170533

13

が、樹脂フィルム'1'にエキシマレーザ等によって穿孔されたものでは、図10に示すように、個々の吐出口4が互いにつながることなく、独立して形成されるため、端面(樹脂フィルム面)に付着したインクが、隣接吐出口間につながることなく、隣接吐出口のインク噴射を不安定にせしめるることはない。よって、得られる画質も非常に高画質となる。

【0059】なお、ここでは、樹脂フィルム'1'をダイシングソー等で切り出した端面に接合した後、エキシマレーザを照射して吐出口4を形成する例で説明したが、あらかじめ、吐出口4を形成した樹脂フィルム'1'を端面に接合してもよい。また、樹脂フィルムではなく、N₂等の耐インク腐食性に優れた金属製のオリフィスプレートを端面に接合して吐出口としてもよいことはいうまでもない。

【0060】

【発明の効果】請求項1に対応した効果：基板の表裏両面に流路溝を形成した流路基板と、該流路基板の表裏両面に熱エネルギー作用部を形成した発熱体基板を熱エネルギー作用部と流路溝とが相対するよう鏡面して液体噴射記録ヘッドを構成したので、通常の2倍の吐出口配列が得られ、高密度印写が可能となった。

【0061】請求項2に対応した効果：液体噴射記録ヘッドの流路溝を、エッティングによって形成するようにしたので、量産化が可能となった。

【0062】請求項3に対応した効果：液体噴射記録ヘッドの流路溝を、異方性エッティングによって形成するようにしたので、高精度な流路溝が得られ、印写性能も良好なものとなった。

【0063】請求項4に対応した効果：液体噴射記録ヘッドの流路溝を、(100)面の結晶方位に切り出されたSi基板上に異方性エッティングによって形成するようにしたので、高精度な流路溝が得られ、印写性能も良好なものとなり、さらに材料入手が容易になったので、高精度かつ安価に液体噴射記録ヘッドが製作できるようになった。

【0064】請求項5に対応した効果：流路基板の寸法を最適化したので、液体噴射記録ヘッドの歩留まりがよく、安定して製作できるとともに、必要以上に製作コストがかからず、安価に液体噴射記録ヘッドが製作できるようになった。

【0065】請求項6に対応した効果：吐出口の配列精度は流路基板厚さの精度に依存するが、流路基板厚さのバラツキを流路溝深さの1/2以内としたので、最終的な吐出口配列精度が向上し、高画質印写が実現した。

【0066】請求項7に対応した効果：発熱体基板に、流路溝に記録媒体を導くための開口を有するようにしたので、微小な構成のインク供給部とする必要がなく、液

14

体噴射記録ヘッド製作が容易になった。

【0067】請求項8に対応した効果：流路溝の記録液体吐出部分に、流路溝に対応して2列配列に吐出口を形成したオリフィスプレート部材を有するようにしたので、吐出口部分の形状が良好なものとなり、隣接吐出口間の相互干渉もなくなったので、インク吐出性能が安定し、より一層の高画質印写を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明を適用するインクジェットヘッドの一例を示す図である。

【図2】 本発明を適用するインクジェットヘッドのインク滴吐出原理を説明するための図であり、(A)～(G)は各吐出工程を示す。

【図3】 インクジェットヘッドの一実施例を示す。

【図4】 インクジェットヘッドの裏部断面図であって、(A)はその吐口から見た正面断面図、(B)は(A)におけるB-B線で切断した場合の切断部分断面図である。

【図5】 インクジェットヘッドの断面図であり、

20 (A)は吐出口面を切り出したインクジェットヘッドの吐出口面を、また、(B)は異方性エッティングで流路を切り出したインクジェット吐出面を示している。

【図6】 形成される表側の流路群の底部と裏側の流路群の底部間の距離と形成される流路の溝幅の関係を説明するための図である。

【図7】 許容できる流路基板の厚さのバラツキ△dと流路の溝の深さcとの関係を説明するための図である。

【図8】 流路溝にインクを供給する手段の一実施例を説明する図である。

30 【図9】 流路溝にインクを供給する手段の他の実施例を説明する図である。

【図10】 吐出面の端面に樹脂フィルムを接合したインクジェットヘッドを示す図である。

【図11】 エキシマレーザを照射することによって吐出口が形成されたインクジェットヘッドを示す図である。

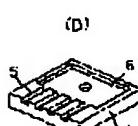
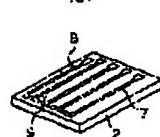
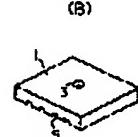
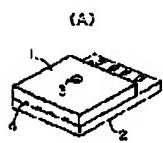
【符号の説明】

1…流路基板(蓋基板)、1'…樹脂フィルム、2…発熱体基板、3…記録液体流入口、4…オリフィス、5…45 流路(流路溝)、6、6'…液室を形成するための領域、7…個別(独立)電極、8…共通電極、9…発熱体、10…インク(インク柱)、11…気泡、12…液滴、13…流路基板、14…吐出口、15…液吐出部、16…熱作用部、17…熱発生部、18…熱作用面、19…下部層、20…発熱抵抗層、21…上部層、22、23…電極、100…記録ヘッド、101…電気熱変換体。

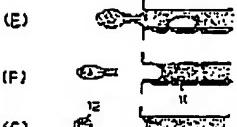
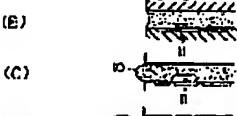
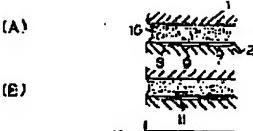
(9)

特開平11-170533

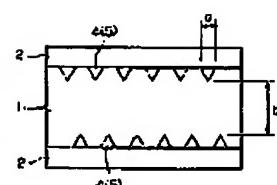
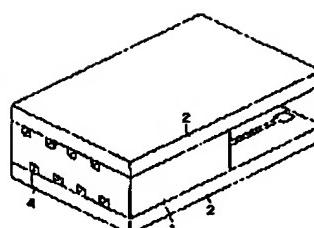
【図1】



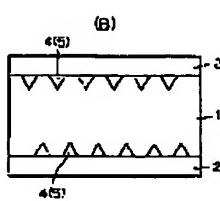
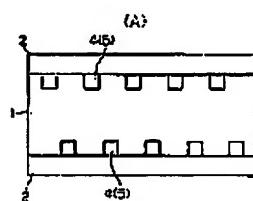
【図2】



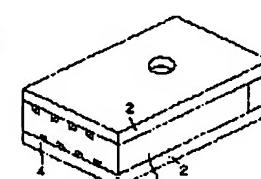
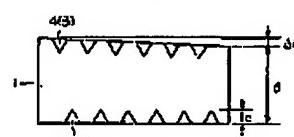
【図3】



【図5】

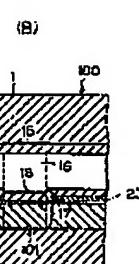
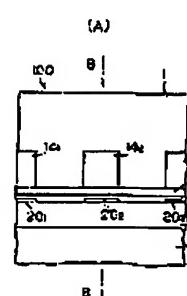


【図7】

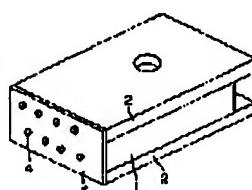


【図8】

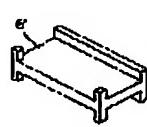
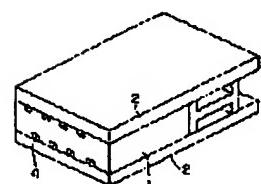
【図4】



【図10】



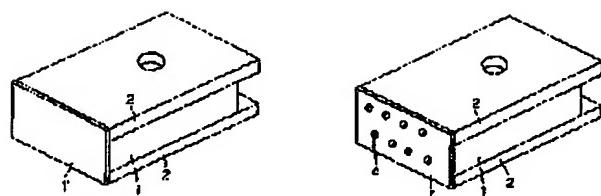
【図9】



(10)

特開平11-170533

【図11】



特開平11-170533

【公報査別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成14年8月28日(2002.8.28)

【公開番号】特開平11-170533

【公開日】平成11年6月29日(1999.6.29)

【年造号数】公開特許公報11-1706

【出願番号】特願平9-346346

【国際特許分類第7版】

B41J 2/05

2/16

【F I】

B41J 3/04 103 B

103 H

【手続補正旨】

【提出日】平成14年6月7日(2002.6.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 流路内の記録液体にエネルギーを作用させるためのエネルギー発生手段を有し、該エネルギーの作用力で吐出口より前記記録液体を液滴として飛翔させ、該記録面に着付させて記録を行う液体噴射記録ヘッドにおいて、該液体噴射記録ヘッドは、基板の表裏両面に流路溝を形成した流路基板と、該流路基板の前記表裏両面に前記エネルギー作用部を形成するエネルギー作用基板を前記エネルギー作用部と前記流路溝とが相対するよう逆位してなる液体噴射記録ヘッド。

【請求項2】 前記流路溝は、エッティングによって形成することを特徴とする請求項1記載の液体噴射記録ヘッド。

【請求項3】 前記流路溝は、異方性エッティングによって形成することを特徴とする請求項1又は2に記載の液体噴射記録ヘッド。

【請求項4】 前記流路溝は、(100)面結晶方位に切り出されたSi基板上に異方性エッティングにより形成することを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の液体噴射記録ヘッド。

【請求項5】 前記流路基板は、形成される表面の流路溝群の底部と裏面の流路溝群の底部の距離が、形成される溝幅の8倍以上であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の液体噴射記録ヘッド。

【請求項6】 前記流路基板の厚さは、その厚さの1/2を前記流路溝深さの1/2内であることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の液体噴射記録ヘッド。

【請求項7】 前記エネルギー作用基板は、前記流路溝に記録液体を導くための開口を有することを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の液体噴射記録ヘッド。

【請求項8】 前記流路溝の記録液体吐出部分に、前記流路溝に対応して2列配列に吐出口を形成したオリフィスプレート部材を有することを特徴とする請求項1乃至7のいずれかに記載の液体噴射記録ヘッド。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正内容】

【0007】

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、流路内の記録液体にエネルギーを作用させるためのエネルギー発生手段を有し、該エネルギーの作用力で吐出口より前記記録液体を液滴として飛翔させ、該記録面に着付させて記録を行う液体噴射記録ヘッドにおいて、該液体噴射記録ヘッドは、基板の表裏両面に流路溝を形成した流路基板と、該流路基板の前記表裏両面に前記エネルギー作用部を形成するエネルギー作用基板を前記エネルギー作用部と前記流路溝とが相対するよう逆位してなる液体噴射記録ヘッドである。

【手續補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正内容】

【0013】請求項7の発明は、請求項1乃至6のいずれかに記載の液体噴射記録ヘッドにおいて、前記エネルギー作用基板は、前記流路溝に記録液体を導くための開口を有する液体噴射記録ヘッドである。

【手續補正4】

特開平11-170533

【補正対象音類名】明細書

【補正対象項目名】0060

【補正方法】変更

【補正内容】

【0060】

【発明の効果】請求項1に対応した効果：基板の表裏両面に流路溝を形成した流路基板と、該流路基板の表裏両面にエネルギー作用部を形成したエネルギー作用基板をエネルギー作用部と流路溝とが相対するように積層して液体噴射記録ヘッドを構成したので、通常の2倍の吐出

口配列が得られ、高密度印写が可能となった。

【手続補正5】

【補正対象音類名】明細書

【補正対象項目名】0066

【補正方法】変更

【補正内容】

【0066】請求項7に対応した効果：エネルギー作用

基板に、流路溝に記録液体を導くための開口を有するようになして、微小な構成のインク供給部とする必要がなく、液体噴射記録ヘッド製作が容易になった。